



致冷晶片 Thermoelectric Cooling Chip

產品特性 Features

- 體積小、輕量化
Small bulk and light weight
- 無動件、低噪音
No vibration and noise-free
- 精確控溫
Precise temperature control
- 可靠度高
High reliability

產品應用端 Applications

適用於極端環境 Rugged environment durable

廣泛用於冰箱、飲水機、醫療 / 軍用儀器和實驗科學儀器，需要溫度反覆變化的熱循環 (Thermal Cycle) 應用情境。此外，致冷晶片也已大量導入於半導體晶圓的製程溫度控制上。

It's widely used in medical equipment, freezer, drinking fountains, military petroleum instruments as these applications need thermal cycling control. Besides, it's also widely being applied to control the temperature during fabrication of semiconductor.

產品物性 Properties

Size(mm)	Height(mm)	I _{max} (A)	V _{max} (V)	Watt(W)	最大致冷量 @27° C Q _{max} (W)	最大致冷量 @50° C Q _{max} (W)	R(Ohm)
15×15	3.1	6.0	3.8	22.8	13	14.3	0.45±10%
	3.4	8.5	2.1	17.9	10.3	11.3	0.20±10%
	3.6	3.9	3.8	14.8	8.6	9.5	0.85±10%
	3.8	3.0	3.8	11.4	7.3	8	1.00±10%
	3.9	6.0	2.1	12.6	7.4	8.2	0.30±10%
	4.7	2.0	3.8	7.6	4.4	5	1.65±10%
20×20	3.1	6.0	8.8	52.8	29.7	32.7	1.05±10%
	3.4	8.5	3.8	32.3	18.8	20.8	0.35±10%
	3.6	3.9	8.8	34.3	18.7	20.9	1.95±10%
	3.8	3.0	8.8	26.4	16.6	18	2.20±10%
	3.9	6.0	3.8	22.8	13.6	14.9	0.55±10%
	4.7	2.0	8.8	17.6	10.2	11.2	3.70±10%
30×30	3.15	6.0	15.7	94.2	53.1	59.1	1.90±10%
	3.45	8.5	8.8	74.8	43.1	48	0.85±10%
	3.65	3.9	15.7	61.2	35.2	39	3.50±10%
	3.85	3.0	15.7	47.1	29.8	32.5	4.00±10%
	3.95	6.0	8.8	52.8	31.1	34.2	1.25±10%
	3.95	6.0	11.8	70.8	48	52.8	1.65±10%
	4.75	2.0	15.7	31.4	18.2	19.5	6.70±10%
40×40	3.45	8.5	15.7	133.5	77.1	85	1.50±10%
	3.95	6.0	15.7	94.2	55.6	61	2.20±10%

► For special sizes, please contact our product consultants.

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250124



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或 訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。